



CBTech[®]

川寶科技股份有限公司
CHIME BALL TECHNOLOGY CO. LTD.

法人說明會

股票代碼: 1595

Presented by : 川寶科技董事長 張鴻明
寶虹科技總經理 呂理宏
111年11月09日

創新

Create

卓越

Best

科技

Technology

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

議程

營運概況

財務概況

未來展望

集團布局

Q&A

川寶集團成員暨重要關係企業

川寶科技 (CBT)
Chime Ball Technology Co., Ltd.

PCB 軟硬板曝光機/軟板RTR曝光機
PCB 軟硬板線路LDI/防焊DI 直接成像曝光機
研發製造

寶虹科技 (BHT)
Bao Hong Semi Tech Co., Ltd.

半導體晶圓製造設備
先進晶圓傳送系統
關鍵零件供應商

川康國際貿易 (CBT-SH)
CBT International (SH) Co., Ltd.

川寶 / 寶虹 大陸地區零件銷售與設備維修售服貿易公司

寶驊科技
Bao Hua Technology Co., Ltd.

半導體AOI 2D / 3D 影像檢查機
自動化軟體開發與服務

抱樸科技
Pure Metallica Co., Ltd.

PEALD / ALE 薄膜 / 蝕刻製程應用
PEALD / ALE 薄膜 / 蝕刻專利佈局

集團公司位置分布圖

川寶集團全球分布
為滿足PCB/半導體產業需求川寶集團在全球建立優質服務銷網路，目前已建立5個據點區

- ✓ 台灣
- ✓ 中國
- ✓ 韓國
- ✓ 泰國
- ✓ 美國

北美研發&服務辦公室
Santa Clara, CA

泰國辦事處
Bangkok, Thailand

中國華南分公司
Dongguan, China

中國華東分公司
Kunshan, China

川寶集團總部
Taoyuan City, Taiwan

川寶研發中心 / 寶虹科技
Hsinchu City, Taiwan



集團產品線

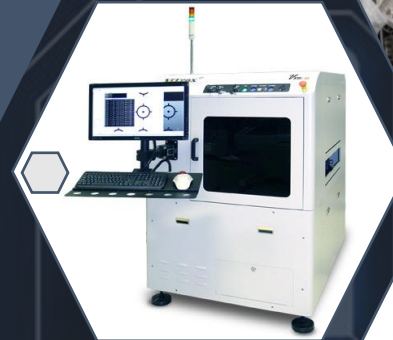


半導體前段成熟製程設備



後段封裝及PCB曝光機

2D, 3D 自動光學檢查機 (AOI)



PEALE/ALD 原子層沉積開發應用

設備零件代理銷售



先進高階表面塗層處理 (AST)



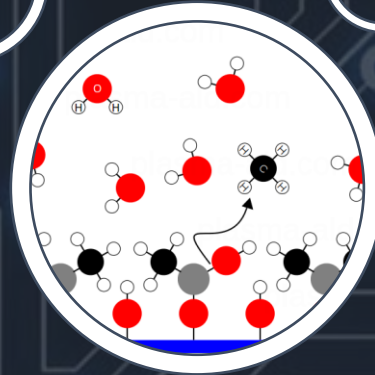
集團專利佈局

曝光機及直接成像曝光機

63項專利



PECVD (ALD) & ALE
25項專利



Semi Fab Tools Automation, N2
EFEM (ATM), VTM Transfer Module
10項專利



川寶集團各事業體持續投入研發新設備,並同時申請各項專利保護研發成果及維持競爭力



經營績效及財務報告

2018~2022 Q3 合併營收、毛利率、 淨利率、EPS 及現金股利殖利率

單位:新台幣仟元

	2018	2019	2020	2021	2022 Q3
合併營收	1,756,286	1,729,528	1,692,149	2,417,036	1,418,639
毛利率	30.31%	25.91%	21.83%	25.09%	25.13%
淨利率	11.19%	5.58%	0.51%	7.63%	16.32%
EPS	4.18	2.06	0.18	3.93	4.98
現金殖利率	4.08%	2.97%	1.46%	4.74%	-
每股淨值	51.6	50.78	49.69	53.4	56.81

2021 Q3和2022 Q3的合併綜合損益表

科目	2021 Q3	%	2022 Q3	%	YoY
營業收入	1,750,739	100%	1,418,639	100%	-19%
營業毛利	436,824	25%	356,446	25%	-18%
營業費用	253,590	14%	278,527	20%	10%
營業淨利	183,234	10%	77,919	5%	-57%
營業外收支	(20,210)	-1%	231,230	16%	1244%
稅前淨利	163,024	9%	309,149	22%	90%
所得稅費用	36,024	2%	77,625	5%	115%
稅後淨利	127,000	7%	231,524	16%	82%
每股盈餘 (元)	2.72		4.98		83%

單位:新台幣仟元

2021 Q3、2021 Q4和2022 Q3的合併資產負債表

科目	2021 Q3	%	2021 Q4	%	2022 Q3	%
現金及約當現金	931,092	20%	1,019,832	22%	1,415,595	28%
應收款項	932,442	21%	932,822	21%	639,810	12%
存貨	1,116,996	25%	1,118,223	25%	1,496,776	29%
其他流動資產	347,579	8%	302,379	7%	419,482	8%
不動產、廠房及設備	686,611	15%	644,660	14%	748,907	14%
無形資產	388,864	9%	379,860	8%	353,441	7%
其他非流動資產	104,566	2%	107,395	2%	100,155	2%
資產總計	4,508,150	100%	4,505,171	99%	5,174,166	100%
流動負債	1,902,523	43%	1,775,274	40%	2,254,276	43%
非流動負債	146,701	3%	208,488	5%	249,541	5%
負債總計	2,049,224	46%	1,983,762	45%	2,503,817	48%
普通股股本	471,481	10%	471,481	10%	469,261	9%
資本公積	552,126	12%	553,718	12%	555,669	11%
保留盈餘	1,448,891	32%	1,506,186	33%	1,640,532	32%
其他權益	(7,667)	0%	(3,323)	0%	424	0%
庫藏股	(10,480)	0%	(10,480)	0%	0	0%
非控制權益	4,575	0%	3,827	0%	4,463	0%
權益總計	2,458,926	54%	2,521,409	55%	2,670,349	52%

單位:新台幣仟元

未來展望

(主要事業體營運規劃)

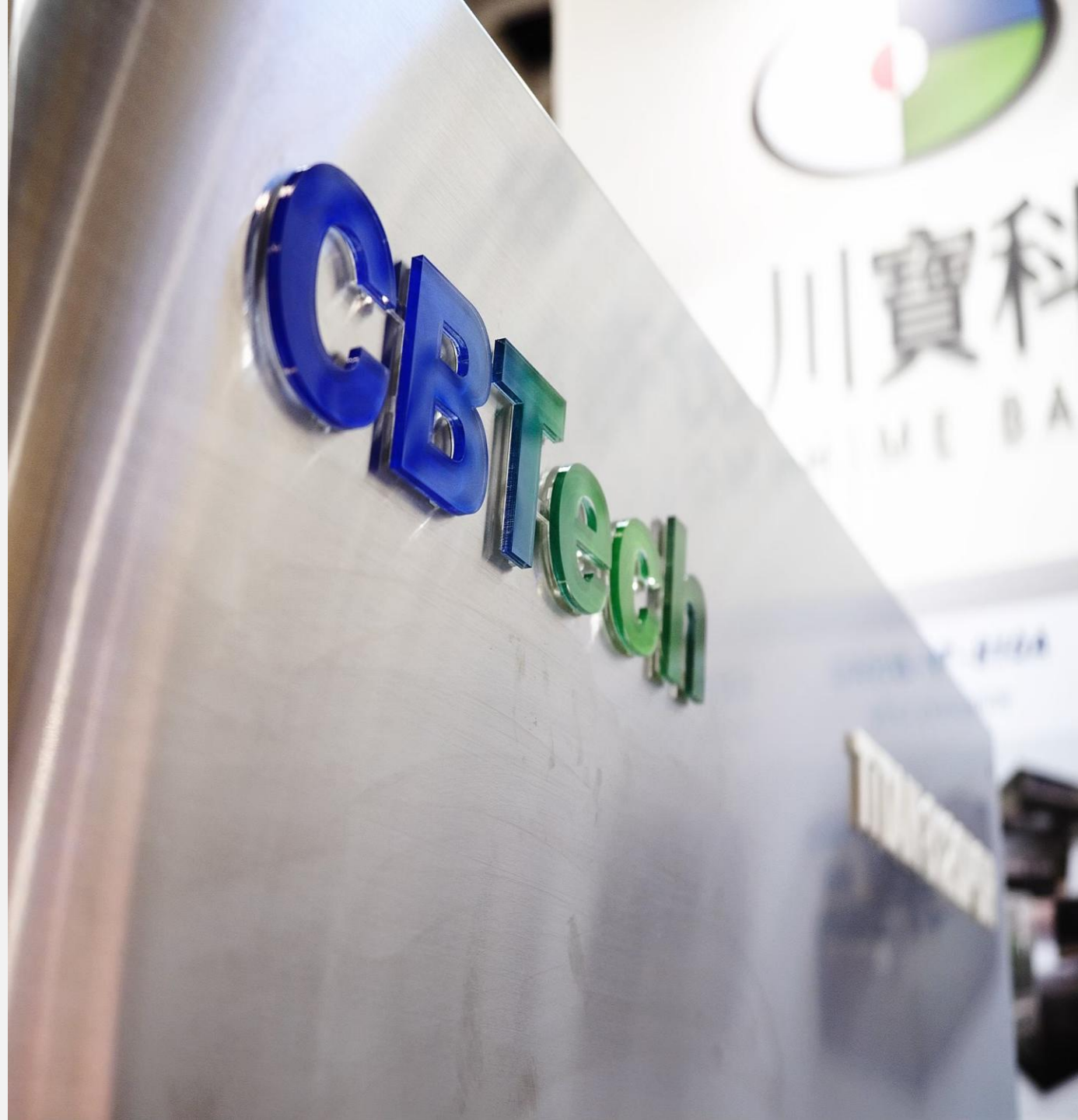


PCB BU未來展望

目前產業發展

2021年台灣電路板產業全年統計產值為8,178億新台幣，年成長17.5%，是繼2010年後成長幅度最大的一年。

在5G、半導體、電動車及其他創新科技帶動下，台灣電路板產業有望再攀高峰，但面臨地緣政治衝突、通膨、新冠病毒、中國設備競爭以及淨零碳排趨勢興起等等因素，導致2022年旺季不旺的情況發生。未來一年設備業的發展，公司持保守看待。



未來5年3大主軸產品



接觸式曝光機

軟板RTR 捲對捲曝光機

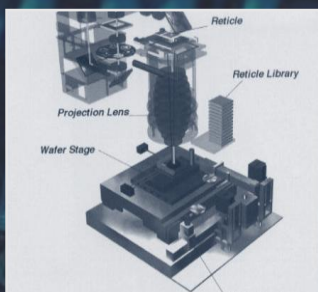
太陽能板投影式曝光機



PCB/Substrate 直接成像曝

光機線路 LDI 5 μ m~40 μ m

防焊 DI



Substrate/ 2.5D 3D IC

Stepper

提供5G、電動車、
高速運算 (HPC)、
人工智慧 (AI)、
伺服器、電動車及
太陽能板投影等曝
光機應用解決方案

川寶未來5年營運計畫

市場守成 (2023 ~ 2025)

- 傳統曝光機/RTR軟板曝光機
- 線路 LDI / 防焊DI 直接成像曝光機
- 太陽能板投影曝光機

應用提升 (2023 ~ 2025)

- 5 μ m LDI 開發布局BT載板市場
- 3 μ m Stepper 開發布局ABF載板及2.5D/3D封裝市場

高階轉進 (2025 ~ 2027)

- BT & ABF 載板 LDI & Stepper曝光設備
- 2.5D/3D封裝RDL曝光設備



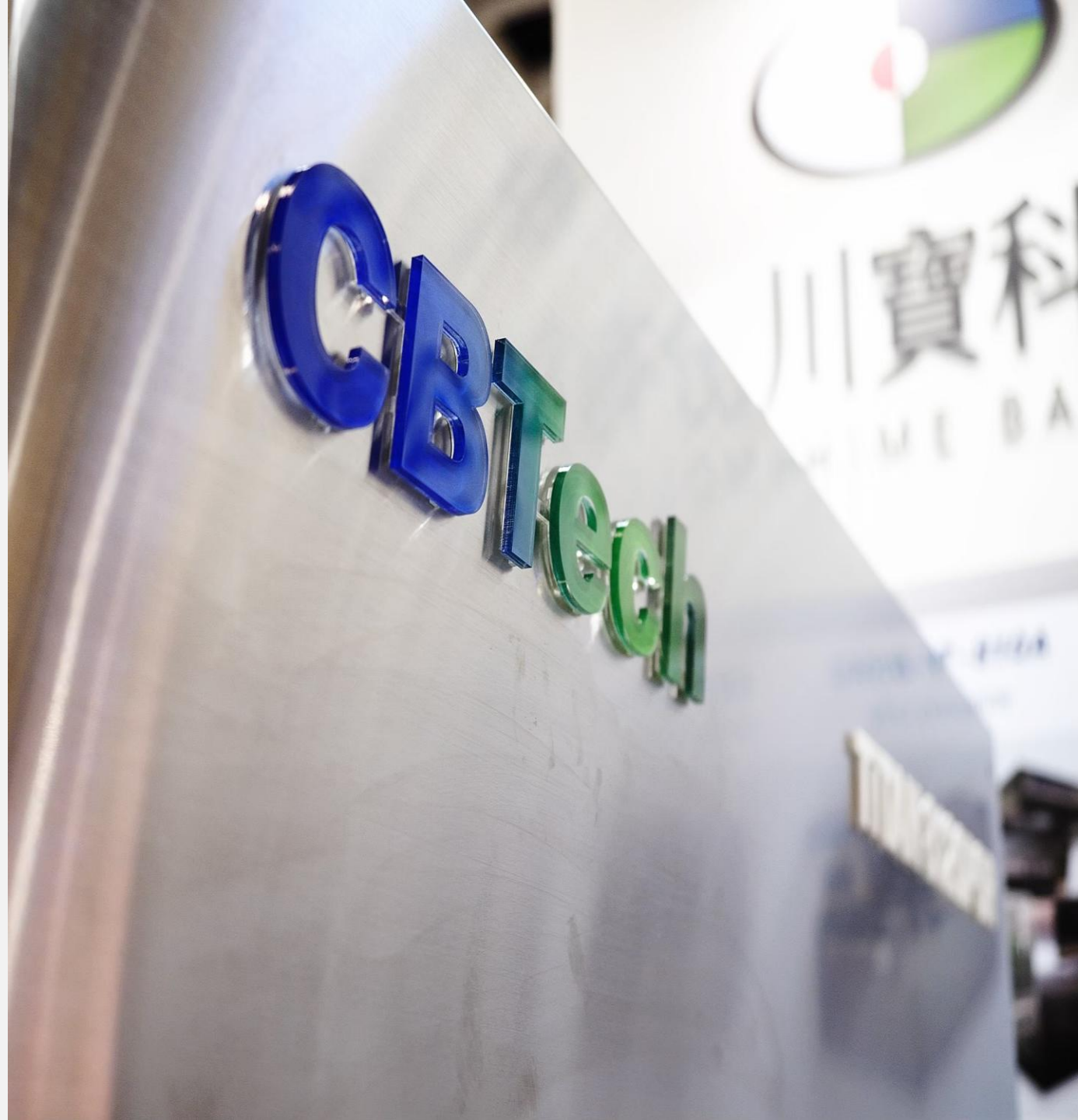
SEMI BU 未來展望



目前產業發展

過去兩年由於成熟製程設備需求旺盛，後疫情時代供應管理等各種因數導致原廠新設備的交貨期延長，半導體製造商被迫採取應對措施，以取得再生半導體設備為主要因應對策，導致設備價格飆升，因此成熟製程設備的市場表現不俗。

展望2023年，半導體產業雖面臨著地緣政治與禁令問題、供應管理以及半導體人才缺口各種因素，不論從成本或交期考量，取得再生設備仍會是主要對策，因此預期寶虹在成熟製程營收表現仍有成長空間。



寶虹未來5年3大產品主軸與戰略核心



半導體設備製造中心



先進晶圓傳送系統製造中心



半導體零組件製造中心

提供半導體設備
及關鍵零組件在
地化解決方案為
戰略核心



集團布局

集團戰略聚焦

■戰略聚焦『一個核心與兩大研發中心為主軸』

■設立集團永續發展委員會與兩大研發中心，以企業永續為核心，兩大研發中心為羽翼



■永續發展委員會著眼公司轉型要由「製造」變「科技」專注技術培養與企業長期發展，秉持「公司治理與誠信經營」、「綠色產品與環境保護」及「照顧員工與關懷弱勢」，成為國內標竿企業典範，追求永續經營發展



■竹科研發中心著眼在先進製程設備自動化、軟體控制以及機構開發與設計



■蘆竹材料研發中心著眼於光學設計、光學鍍膜、真空表面處理與材料開發

集團永續發展藍圖

■永續發展秉持3R 『REUSE, REDUCE & RECYCLE』

■響應全球淨零排放趨勢與友善環境、持續研發創新、提供客戶永續發展方案



REUSE

■集合研發能量提供設備與關鍵零組件在地化製造、提供再生解決方案



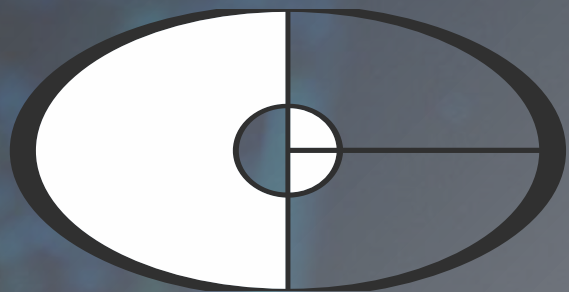
REDUCE

■持續投資、引進綠色與優化製程設備，並導入智慧節能管理的系統



RECYCLE

積極投入再生、循環經濟技術研發，協助客戶推動淨零排放解決方案



川寶集團

創新

Create

卓越

Best

科技

Technology